



- 2025 年度各賞受賞候補者の推薦について
- 2026 年度会員会費の口座引落日のお知らせ及び会費自動振替制度ご利用のお願い
- Best Author 賞（JWS Best Author Award）の推薦について
- WEB 掲載の溶接学会論文集 43 巻（2025 年度）の印刷物の購入について
- 2026 年度春季全国大会講演概要の頒布について
- Mate+ Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics” plus
「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム + 参加者募集

2025年度各賞受賞候補者の推薦について

下記により 2025 年度佐々木賞、田中亀久人賞、溶接学会業績賞、溶接学会技術貢献賞、妹島賞の各受賞候補者を募集いたしますので、適格者がございましたら、所定の推薦書（本会 HP より入手下さい）によりご推薦下さいますようお願いいたします。

項 目	佐々木賞	田中亀久人賞	溶接学会業績賞	溶接学会技術貢献賞	妹島賞
授 賞 対 象	多年にわたり溶接技術の開発、又は応用・普及に関し、その業績顕著なもの及び溶接技術について後進の教育指導、育成の業績顕著な者。	ガス炎を利用した溶接・切断・工作等及び溶接技術全般に関し、研究・技術開発についてその業績顕著な者。	溶接の学術に関する各部門において優秀な業績を挙げた者。	溶接技術の開発、又は応用普及に中核的な役割を果たし、その業績顕著なもの及び溶接技術について若手技術者への教育・指導・育成の業績顕著な者。	溶接プロセス（ハード及びソフト）に関する技術開発並びにその応用に尽力し、長年に亘って生産・製造において多大な貢献のあった者（個人又は団体）
候補者資格	本会正員	本会会員に限らない			
推薦者資格	本会会員				
推 薦 手 続	次の事項を記載した推薦書（所定の書式）を学会長宛（溶接学会事務局）に付属資料とともに電子メールで提出する。 イ、候補者の氏名、職業・勤務先・役職名 ロ、候補者の略歴 ハ、賞を受けようとする業績の詳細（裏付となる資料を添付） ニ、推薦者の氏名、連絡先 溶接学会業績賞については、賞を受けようとする該当分野とそこでの学術に関する業績の詳細及び該当分野に関する論文リストを添付する。溶接学会技術貢献賞については、賞を受けようとする業績の詳細を添付する。				
推薦書提出期限	2025 年 12 月 31 日				
授賞年月日	2026 年 4 月 22 日を予定（第 94 回通常総会）				
そ の 他	多年にわたる業績をお考え下さい。年令に制限はありませんが、溶接に通算 15 年以上関与したことを原則とします。 また、その業績には公的な活動が含まれていることが望ましい。 業績については詳細に述べ、十分な裏付資料を添付するようにして下さい。	佐々木賞が多年にわたる業績（功労）を対象とするのに対し、本賞はある時期に示された優れた業績を対象とします。 特許資料、公刊誌への発表・紹介など、業績を裏付けるための十分な資料を添付して下さい。	第1部門： 溶接・接合、熱加工プロセス及び機器 第2部門： 制御、システムの工学・技術及び組立実装技術 第3部門： 材料及び溶接・接合性 第4部門： 材料・製品の強度・破壊と設計 第5部門： 施工・管理及び品質保証・品質管理 第6部門： 新領域・境界技術	佐々木賞と同様、開発並びに技術普及・教育等の活動を含めて複数の業績があり、年令は 45 才以下であることを原則とします。 業績については詳細に述べ、十分な裏付資料を添付するようにして下さい。 ※受賞時には、本会会員であることが必要です。	故 妹島五彦君による寄贈基金で運用されており、妹島君が活躍された溶接プロセス分野の業績をお考え下さい。

2026年度会員会費の口座引落日のお知らせ及び会費自動振替制度ご利用のお願い

本会では事務の省力化のため、金融機関預金口座振替システムを利用した「会費自動振替制度」を実施しておりますのでご利用をお願いいたします。会員会費の納入方法を口座引落しされている方の2026年度会費の口座引落日及び会費は次のとおりです。ご準備くださいますようお願いいたします。

口座引落日：2025年12月23日（火）

2026年度正員会費	13,000円
2026年度学生会費	6,000円
2026年度賛助員会費	42,000円×口数

なお、会費の未納分がある方は、2025年度会費とあわせて引き落とさせていただきます。

引き落としがされますと通帳に「MFS（ヨウセツカイヒ）」（個人会員の会費の略）と記入されます（お取引金融機関により若干異なる場合もあります）。

領収書は原則として発行いたしません。発行を希望される方は、引落としを確認後領収書を発行いたしますので、事務局までお申し出ください。

口座引落としについての問い合わせ先：

一般社団法人溶接学会 会員係

TEL 03（5825）4073

引落口座の変更等は10月末日までにご連絡下さい。

Best Author賞（JWS Best Author Award）の推薦について

下記により Best Author 賞の推薦を募集いたします。

本年第1号（1月号）から第8号（12月号）までに会誌に掲載された記事の中から優秀と認められるものを、巻号、題名、著者、推薦理由を記して、1編、編集委員会宛ご推薦下さい。

（2026年1月31日まで）

【賞の概要】

会誌「溶接学会誌」に発表された記事のうち、特に多数の会員の研鑽、及び、学術、技術の向上、普及に貢献した記事の著者に授与される。

【選考委員】

同賞選定委員会

委員長：会誌編集委員長

委員：編集委員より数名（各分野代表＋総合企画＋副委員長）

【選考方法】

会誌編集委員および会員モニタの推薦による記事の中から選定委員会で選定する。

【選考基準】

溶接学会誌の本年第1号（1月号）から第8号（12月号）までに掲載された記事の中から、優秀と認められるものを、原則として毎年数編以内選定する。

【表彰等】

4月通常総会席上で表彰、賞状の贈呈。

【推薦書送付先】

（一社）溶接学会 編集委員会宛

WEB掲載の溶接学会論文集43巻（2025年度）の印刷物の購入について

溶接学会論文集は、2007年1月より印刷物での発刊に代わってホームページ上にてWEB版として発刊されております。

印刷物にて一年分を纏めたものを購入される方は、下記により、2026年3月31日までにお申込み下さいますようお願いいたします。

溶接学会論文集43巻（2025年度）

【価格】 15,900円／冊（消費税10%込・送料別）

【申込先】 「お名前（会社名）」「送付先住所」「冊数」
をご明記の上、FAXにてお申込み下さい。

日本印刷出版株式会社

TEL：06-6441-0075

FAX：06-6443-5815

2026年度春季全国大会講演概要の頒布について

2015年度春季全国大会より講演概要はデジタル化され、配布方法はホームページからのダウンロードのみとなり、従来のような大会前、大会当日の販売は廃止いたしました。

ただし、印刷版の全国大会講演概要は大会終了後、希望者へ別売にて提供させていただきます。

購入を希望される方は下記要領にてお申し込みくださいますようお願いいたします。

2026年度春季全国大会講演概要

価格：12,000円（消費税10%・送料込）

発送時期：2026年6月下旬頃

【申込方法】

「書籍名」「ご連絡先」「お名前」「冊数」をご明記の上、FAXにてお申し込みください。折り返し、請求書をお送りいたします。

一般社団法人溶接学会 全国大会運営委員会 宛

FAX：03-5825-4331

申込締切：2026年5月11日（月）

入金締切：2026年5月29日（金）

なお、入金締切日までにご納入がない場合ご注文はキャンセルとさせていただきます。



Mate+ Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics” plus 「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム + 参加者募集

日 時：2025 年 12 月 9 日（火）～ 10 日（水）

会 場：大阪大学中之島センター

主 催：（一社）スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会

共 催：大阪大学接合科学研究所,（一社）エレクトロニクス実装学会,（公社）化学工学会 エレクトロニクス部会,（一社）レーザ加工学会,（一社）溶接学会マイクロ接合研究委員会

協 賛：IEEE Electronics Packaging Society (EPS) Japan Chapter, 応用物理学会, 大阪大学大学院工学研究科テクノアリーナ インキュベーション部門「つなぐ工学」, 軽金属学会, 精密工学会, 電子情報通信学会, 日本機械学会, 日本金属学会, 日本材料学会, 日本溶接協会, 日本接着学会

【開催趣旨】

1995 年に第 1 回目のシンポジウムが開催された Mate シンポジウムも、参加者の皆様のご支援・ご協力のもと、本年 1 月に開催されました Mate2025 シンポジウムにて 31 回の開催を重ねることができました。次回 Mate2026 シンポジウムは、大学入試シーズンや感染症流行の時期をできるだけ避けるよう、12 月上旬の開催を計画しています。開催時期移行に伴い、次の Mate シンポジウムの開催まで、2 年近く間隔が空くことになります。Mate シンポジウムは、エレクトロニクスにおける接合・実装技術をコアとした最新の生産技術に関して、研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持つことを開催目的としてきました。そこで、これまでと同程度の間隔で、参加者の皆様の発表の場および情報交換の場を提供すべく、本シンポジウムを企画いたしました。開催場所は、EXPO 2025 大阪・関西万博の開催で話題の大阪とさせていただきます。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

【参加申込方法】

<https://glm-p.com/mateplus/>

上記 WEB ページより参加登録を行って下さい。お支払いは銀行振込かクレジット決済をお選びください。

振込期日：2026 年 1 月 31 日（土）

【参加費】* 税込み, 論文集 PDF ダウンロード付

	11 月 10 日まで	11 月 11 日以降
会 員	15,000 円	20,000 円
非会員	20,000 円	25,000 円
学 生	10,000 円	15,000 円

【懇親会】

（日 時）2025 年 12 月 9 日（火）17:00 ～

（場 所）大阪大学中之島センター 2 階
「カフェテリア・アゴラ」

（参加費）5,000 円

【予定プログラム（セッション名と発表件数）】

■基調講演

これからの SDV（Software Defined Vehicle）と電子プラットフォームについて

トヨタ自動車株式会社

デジタルソフト開発センター チーフプロジェクトリーダー

白水 浩一 氏

■講演発表（合計 60 件）

ソルダリング

焼結接合

接着・封止材料

接合・界面反応

有機/無機接合

固相接合

液相拡散接合

配線・接着技術

次世代パッケージ

信頼性評価

システム化・設計・シミュレーション

センサ・デバイス技術

めっき

時間などプログラムの詳細は、WEB ページに掲載の 2nd circular をご覧ください。

【問合せ、申込先】 Mate+ 事務局

（株）GLEAM（グリーンム）内

E-mail：mate@glm-p.com

Phone：06-4798-2078